



聯策科技股份有限公司

2026 第二季法人說明會

2026.06.24



主講人：陳識翔

電 話：(03)369-0966

郵 件：spokesman@synpower.com.tw

免責聲明

本簡報及相關資訊係依據本公司目前可取得之資料、營運狀況及市場環境所編製，內容僅供投資人參考，並非對未來營運成果、財務表現或股價表現之保證。

本簡報中如涉及未來展望、營運方向、產品發展或市場趨勢等前瞻性陳述，可能受到市場需求、產業競爭、政策法令、匯率變動、總體經濟情勢及其他本公司無法掌控因素影響，實際結果可能與預期有所差異。

本公司不提供財務預測，亦不對特定客戶、接單金額、毛利率或尚未公開資訊進行說明。相關財務與營運資訊，仍以本公司依法公告之資訊為準。

本簡報內容未經本公司書面同意，不得任意轉載、引用或作為其他用途。

大綱

01 公司介紹

02 營運績效

03 營運展望

01 | 公司介紹

Company Overview





聯策科技 | 智能製造整合服務

聚焦PCB、半導體載板與先進封裝應用，
整合濕製程、檢測與機器視覺設備技術，
提供智慧製造解決方案。



成立時間

2002

上市代號

6658

資本額

3.64億元

集團員工

320+

集團子公司

映利科技 

各式水平濕製程設備

碩晶科技 

PCB 表面處理代工服務



桃園總部



映利科技



碩晶科技

主要營運據點與技術服務網絡

貼近需求
就近服務



營運中心 子公司 服務據點

指標大廠首選夥伴

在兩岸及東南亞市場，聯策已與逾九成 AI 伺服器、高階車用電子及 IC 載板指標大廠建立長期合作關係。

全球服務網絡

技術服務據點橫跨台灣、中國大陸（昆山、東莞）、泰國（曼谷）與印度（清奈），確保零時差的技術支援。

強大研發動能

2025 年啟用的桃園營運總部，整合了跨領域研發團隊與先進產能，持續投入 PCB 與半導體等前瞻技術開發。

從設備代理到 AI 智慧製造解決方案

以代理為起始，深耕自有技術

2002

初創

代理日本外觀機



2004

發展

佈建大陸據點

自研光學量測設備



2010

擴張

自研光學檢測設備

2D碼產品追溯系統

韓國軟板生產設備



2015

轉型

水平濕製程

表面處理代工

影像AI

全場設備自動化



2022

價值創造

AVIOT

AVRIOT智慧製造

載板製造智動化

數據AI

藥水在線分析與
自動添加方案



2025

智慧化整合

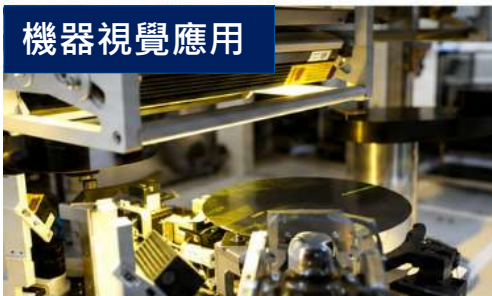
半導體設備

節能系統



核心產品與智慧製造解決方案

機器視覺應用



PCB設備

- AOI / AVI 外觀檢查機
- 日本光學檢查設備(在地整合化)
- 載板多功能方向檢查機
- 自動線寬線距量測機

半導體設備

- 自動光學檢測機
- 玻璃/矽中介層自動光學檢測機
- 基恩斯自動化方案
- 封裝自動化檢測設備

先進濕製程



PCB設備

- 載板濕製程水平線
- 載板薄鍍鉍金藥水與代工
- 在線藥水分析儀
- 玻璃基板專案開發(工研院合作)
- 不溶性陽極

半導體設備

- 全自動槽式清洗設備
- 全自動單片清洗設備
- 供酸系統
- 蒸氣二流體設備

智能化生產與智慧節能



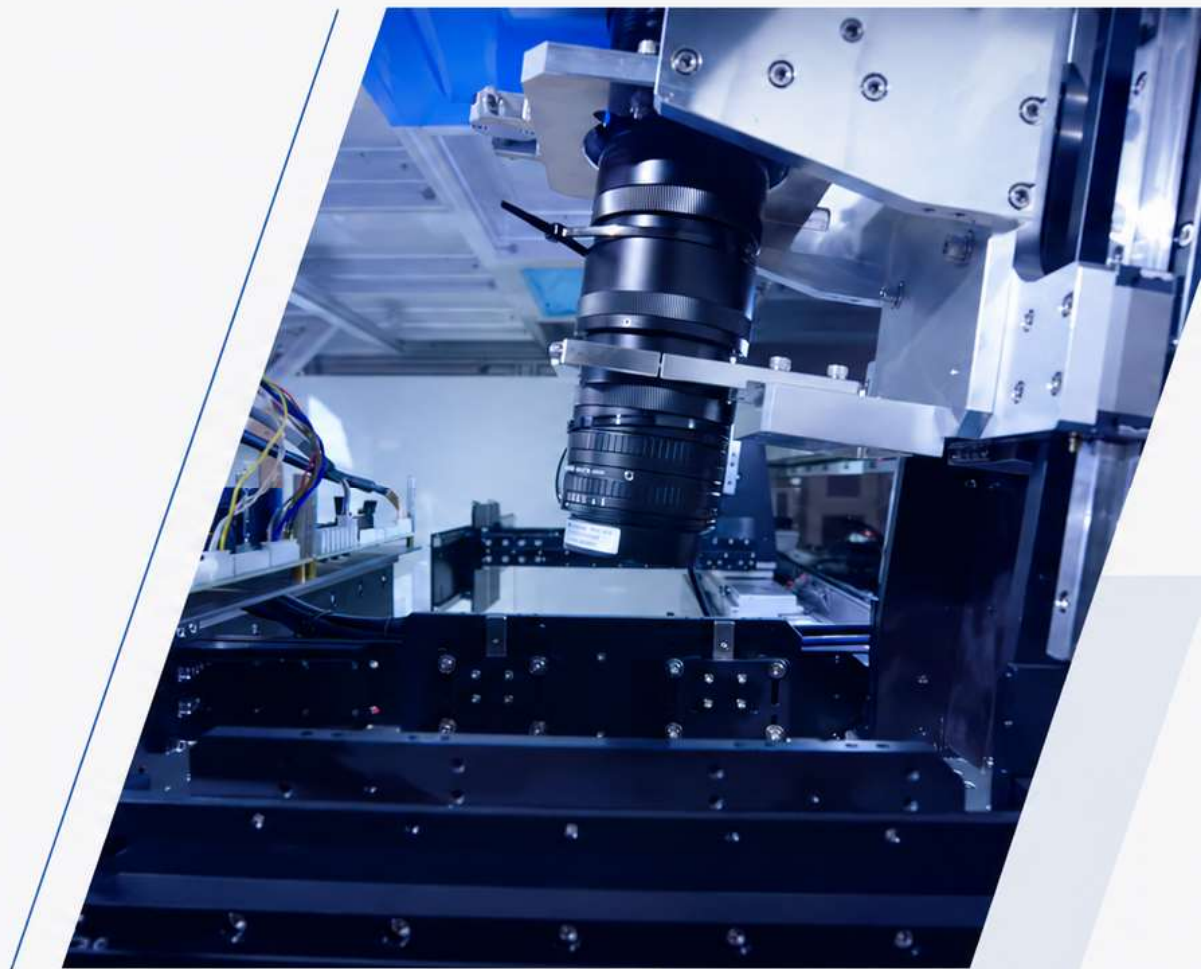
智慧製造

- 影像AI檢測
- 二維碼追溯系統
- AI行為偵測系統
- 廠務智慧化系統
- 數據與影像AI應用

智慧節能

- 低溫節能鼓風機
- 防爆節能集層風機
- 冰水機 (磁懸浮/螺旋式中央空調)
- 中央調控節能系統

02 | 營運績效



經營績效

01 | 2025年合併營收規模較2024年提升

02 | 2026 Q1 營收維持成長，EPS表現
明顯改善

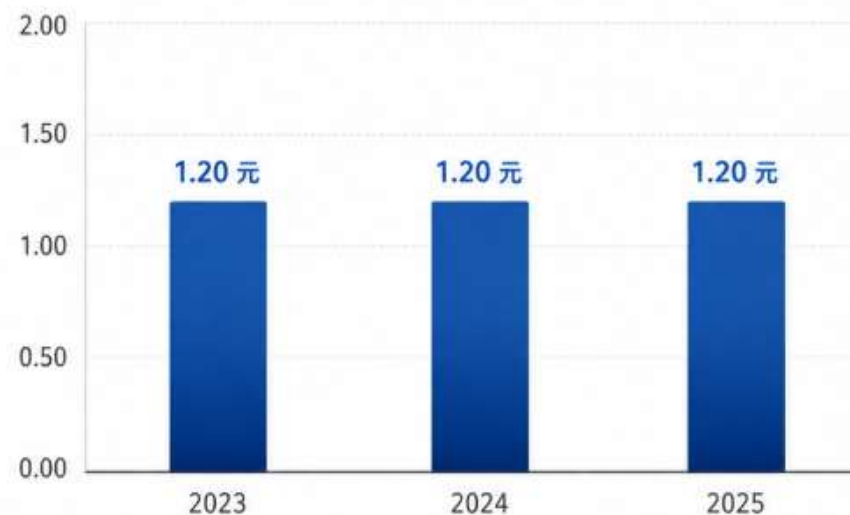
03 | 營運效率與獲利能力提升



股利政策

現金股利趨勢

每股現金股利（元）



註：現金股利以每股配發金額列示。

01 | 股東回饋維持穩定

近三年每股現金股利維持 1.20 元，展現公司持續回饋股東之政策方向。

02 | 穩健現金股利政策

公司在營運發展、資金需求與股東回饋間維持平衡，延續穩健現金股利政策。

03 | 兼顧成長投資與股東報酬

公司股利政策兼顧股東利益、資金需求與長期財務規劃，持續支持產品升級與高階製造應用布局，創造長期價值。

03

營運展望

Business Outlook



AI 伺服器推動高階 PCB / IC 載板升級週期

01 | 需求來源

AI Server / HPC 推升高階 PCB、HDI 與 IC 載板需求。

02 | 產業升級方向

高階 PCB / IC 載板朝多層化、高密度與高良率製程升級。

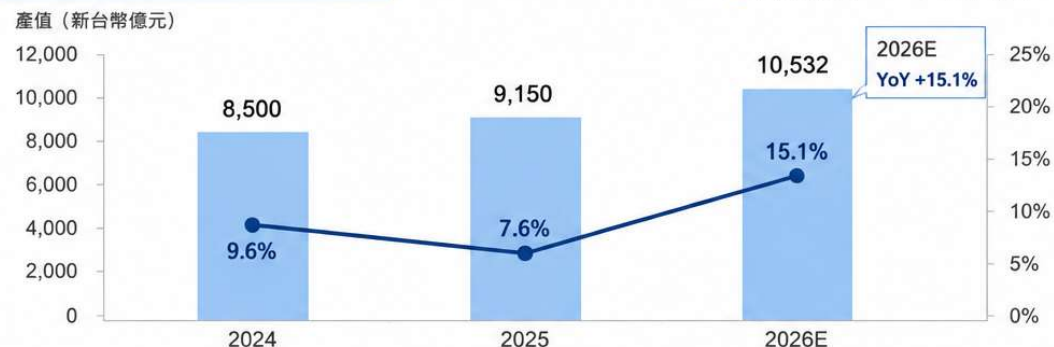
03 | 設備要求

檢測精度、製程穩定、自動化與良率管理成為關鍵。



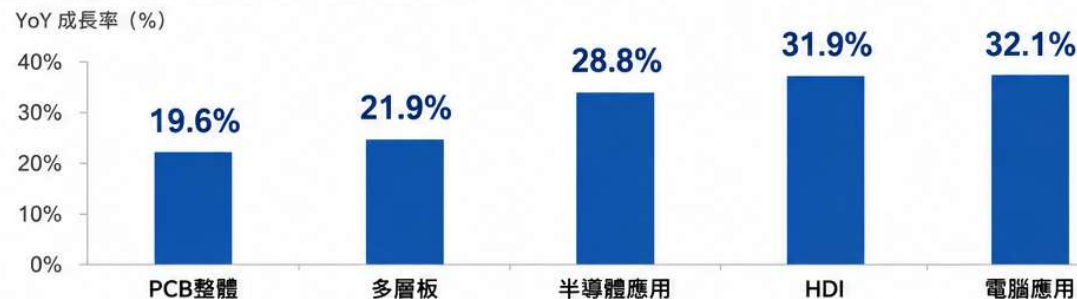
AI 伺服器需求推動高階 PCB / IC 載板升級，帶動檢測、製程穩定與自動化設備需求。

台灣 PCB 產值趨勢與年增率



註：2024-2025 為估計值；2026 為預估值 (E)

2026 Q1 主要產品別 YoY 成長率



註：YoY 係 2026 Q1 與 2025 Q1 比較

資料來源: TPCA & 工研院產科國際所

AI Server 供應鏈升級下的設備應用機會

01 | 高階製程升級



微細線路、高多層與高良率要求提升

02 | 製程穩定需求



濕製程穩定、藥水管理與清洗需求提升

03 | 海外擴產支援



海外新廠導入、追溯管理與在地服務需求提升

聯策解決方案 SynPower

AOI / AVI 外觀檢查、線寬線距量測、載板外觀檢查、AI 複判。

水平濕製程設備、在線藥水分析、XRF 分析、清洗設備、表面處理製程支援。

AVRIOT、智慧工廠戰情室、i360 視覺系統、全廠追溯、AI 能源站、海外服務據點。

先進封裝升級下的玻璃基板技術機會

01 | 清洗 / 蝕刻 / 前處理



表面潔淨、活化、蝕刻與藥水穩定。

聯策解決方案 SynPower

Wafer / Panel 清洗蝕刻 | 蒸氣二流體清洗 | 供酸系統 | 在線藥水分析 | 全濕式製程技術能力

02 | 金屬化 / 導通 / 表面處理



導通穩定、表面處理與金屬層品質控制。

金屬化製程支援 | 高深寬比金屬化製程支援 | 不溶性陽極 | XRF 分析 | 藥水監控

03 | 檢測 / 量測 / 缺陷分析



微孔、孔位、崩邊裂紋與缺陷分類。

玻璃 / 矽中介層 AOI | 孔徑 / 孔位量測 | 孔形缺陷檢測 | AI 缺陷分析 | 大尺寸面板製程驗證

 潛力客群：

IC 載板廠

Glass Core 開發客戶

先進封裝客戶

封測廠

晶圓 / Panel 製程客戶

CPO 載板與光電封裝檢測機會

PCB類載板檢測基礎

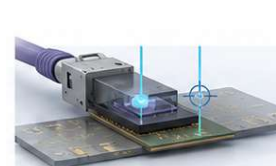
-  **高密度線路檢查**
支援微細線路、微孔、Pad 與外觀缺陷檢測
-  **多重影像檢測**
多角度光源，檢出表面缺陷與孔形異常
-  **AI 缺陷分析**
AI VRS 複判，降低人工判讀依賴

應用場景：CSP 載板 | BT 載板 | 硬板 | 軟板 | RF 板

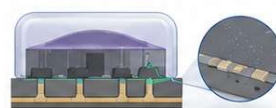
延伸應用



光電封裝延伸機會



-  **光學對位檢查**
支援微細線路、微孔、Pad 與外觀缺陷檢測



-  **封裝外觀檢測**
對應膠材、Pad、表面缺陷與污染檢查



-  **組裝一致性分析**
支援模組化封裝品質控管

應用場景：光模組 | 光引擎 | 矽光子封裝模組

半導體載具檢量測應用

- 01 | 支援 OHT 自動上下料銜接產線
- 02 | FOUP 360° 檢測提升效率並節省空間
- 03 | AI 複判 降低人工判讀依賴
- 04 | 品質履歷支援健康報表與預警分析



SynPower

聯策對應能力

外觀瑕疵檢測

關鍵尺寸量測

FOUP 360° 檢測

AI 缺陷判定

品質履歷管理



3 → 27

檢出項目擴充

原有 3 項提升至 27 項檢出項目

Wafer-to-Panel 製程延伸下的設備對應方案



SynPower

聯策對應方案

01 | 方片 Sorter

方片分選 | 搬運 | 排列 |
上下料 | 製程銜接

02 | Carrier Glass 清洗

表面潔淨 | 殘留物去除 |
清洗前後驗證

03 | Carrier Glass 檢測

外觀缺陷 | 污染刮傷 | 尺寸/位置檢查 |
TGV / RDL 特徵檢查

意見交流與討論

Q&A Session

謝謝指導

